

tesa HAF® 8440

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป HAF ฟิล์มที่ติดโดยการกระตุ้นด้วยความร้อน สีขุ่น หนา 40 ไมครอน

tesa® HAF 8440 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน กาวสองหน้า โปร่งใส ประกอบด้วย thermoplastic copolyamide

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิปเชื่อถือได้
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ PC การ์ด
- สามารถใช้การได้ดีกับสายการผลิตฝังชิปทั่วไป
- ไม่สามารถมองเห็นบน assembled card

การใช้งานหลัก

tesa® HAF 8440 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฝังชิปโมดูลลงในสมาร์ตการ์ด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ไม่มี	• Type of liner	glassine
• Total thickness	40 µm	• Bonding strength	12 นิวตัน/ ตารางมิลลิเมตร
• Type of adhesive	copolyamide		

tesa HAF® 8440



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

ค่าต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่จะใช้เบื้องต้น โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ชิพโมดูล และข้อกำหนดของลูกค้า

1. การติดเคลือบเบื้องต้น:

ช่วงการติดเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบติดบนสายพานโมดูล ขั้นตอนนี้สามารถทำได้แบบอินไลน์หรือออฟไลน์ ขั้นตอนเคลือบติดเบื้องต้นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการเก็บรักษาของเทป

การตั้งค่าเครื่องจักร:

- อุณหภูมิ 130 - 140 °C
- แรงกดทับ 2-3 บาร์
- เวลา 2.5 ม./นาที

2. การฝังโมดูล:

ระหว่างการผลิตโมดูล โมดูลที่เคลือบติดเทปแล้วจะถูกDie-cut

จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าไปในหลุมของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกด สำหรับขั้นตอนนี้ การจัดการที่แน่นอนในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับชนิด implanting line ที่ใช้ สามารถใช้ทั้งแบบกดขั้นตอนเดียวและแบบกดอัดหลายๆครั้ง ปัจจุบันวิธีแบบกดอัดหลายๆครั้งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป

การตั้งค่าเครื่อง - กดอัดขั้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ 180–220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการกดอัดหลายๆครั้ง(การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที /3 x 0.5 วินาที

¹ อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน สำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกันมีการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน มีแนะนำดังนี้:

- *PVC 180 - 190 °C
- *ABS 180 - 190 °C
- *PET 190 - 200 °C
- *PC 200 - 220°C

สำหรับการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝังชิพโมดูล ควรใช้การตั้งค่าเครื่องที่แตกต่างกัน

ค่าความแข็งแรงของการติดได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ค่าที่ได้ได้รับการันตีจากการทดสอบด้วยจำนวนจำกัดในแต่ละชุดการผลิต (วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ Etchedอะลูมิเนียม/สภาวะการติด: อุณหภูมิ = 120 °C; p = 10 บาร์; เวลา = 8 นาที)

สภาพการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF

tesa HAF® 8440

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=08440>